

## 信頼性試験結果 Reliability Test

XC9111Bシリーズ

XC9111B Series

 パッケージ : SOT-23

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen &amp; Antimony-Free

| No. | 試験項目<br>Test Item                        | 試験条件<br>Test Conditions  | 時間<br>Hours | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|--|--|-------------|-----------------------|
| 1   | 高温バイアス<br>High Temperature Bias          | 125°C VDD=(Specified Output Voltage)-0.5V Lx=5V  | 1000        | 0/22                  |
| 2   | 高温保存<br>High Temperature Storage         | 150°C  | 1000        | 0/22                  |
| 3   | 高温高湿バイアス<br>Temperature Humidity Bias    | 85°C85%RH VDD=Lx=10.8V   | 1000        | 0/22                  |
| 4   | 温度サイクル<br>Temperature Cycle<br>(Gaseous) | -55°C~125°C 各30分<br>30min Each   | 100CYC.     | 0/22                  |
| 5   | プレッシャークッカーバイアス<br>HAST                   | 125°C85%RH VDD=Lx=10.8V<br>2×10 <sup>5</sup> Pa  | 100         | 0/22                  |
| 6   | はんだ耐熱<br>Resistance to Soldering Heat    | 85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times<br>→85°C85%RH24h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)1time<br>Moisture Sensitivity Level 1<br>Based on IPC/JEDEC J-STD-020D |             | 0/22                  |
| 7   | 静電耐圧<br>Electric Static Discharge.       | R=0Ω C=200pF ±200V以上 各端子3回<br>±200V over 3times Each   |             | 0/20                  |
|     |  | R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 各端子3回<br>±1kV over 3times Each  |             |                       |
| 8   | ラッチアップ<br>Latch-Up                       | R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回<br>±100V over 3times Each   |             | 0/5                   |
|     |  | 50mA以上<br>50mA over  |             |                       |

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

| No. | 試験項目<br>Test Item           | 試験条件<br>Test Conditions                                  | 試験結果<br>Result<br>r/n |
|-----|-----------------------------|--|-----------------------|
| 1   | 端子引っ張り<br>Terminal Strength | 1N 10秒<br>1N 10s   | 0/5                   |
| 2   | はんだ付け性<br>Solderability     | 230°C10秒(プロファイル昇温法)<br>10s (Temperature profile method ) | 0/11                  |